



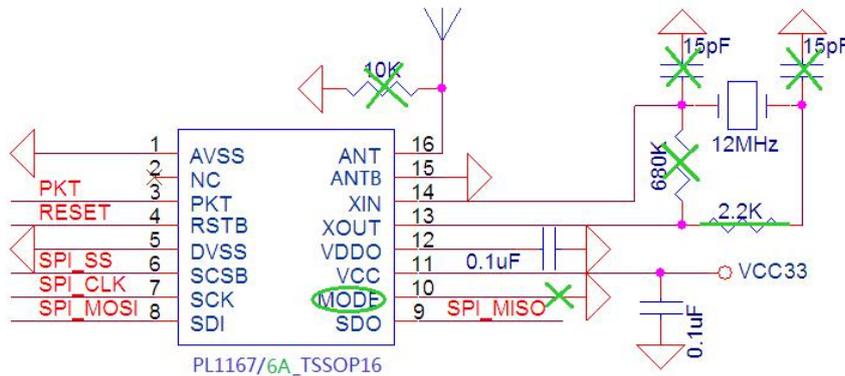
PL1166A 与 PL1167 的对比说明

1. PL1166A 芯片内, 晶振两端 XIN 和 XOUT 分别对地集成了 15pF 电容, 并将 680K 偏置电阻集成, 请选择相匹配的晶体, 与 PL1167 相比, 省掉了 2 颗电容, 2 颗电阻。
2. PL1166A 芯片内, 集成了 ANT 天线端外接的 10K 对地电阻, 外部不需再下拉, 与 PL1167 相比, 省掉了 1 颗 10K 电阻。ANTB 天线端也集成了 10K 对地电阻。
3. PL1166A 采用专利的 MODE 引脚零电流下拉结构, **RSTB 复位时默认选择 SPI 模式**, 如果只需要 SPI 模式, 与 PL1167 相比, 封装时可省去一根 MODE 打线。
4. PL1166A 寄存器配置与 PL1167 完全兼容。

基于以上优化改进, PL1166A 外围电路相比 PL1167 大大简化, 下图绿色部分即为与 PL1167 相比示意图, 省掉的外围共计 5 颗阻容器件; 再加上 MODE 引脚零电流下拉结构, 如只需要 SPI 模式时封装可以省去 1 根邦定线; 最精简模式下可以省掉 5 颗阻容器件、1 根邦定线, 大大简化了设计与成本。

注: RSTB 需要保证系统复位充分。

SPI Mode



I2C Mode

